



RE933-08

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 38
- Pitch: 0,50 mm (173 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 23,50 x 28,57 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE933-08	0,500 mm	19,6	38	6,100 (240 mil)